

Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8622 Wetzwil
Telefon +41-44-931 10 50
Telefax +41-44-931 10 51

www.simpex.ch
contact@simpex.ch
CHE-108.018.777 MWST

 **SIMPEx**
electronic

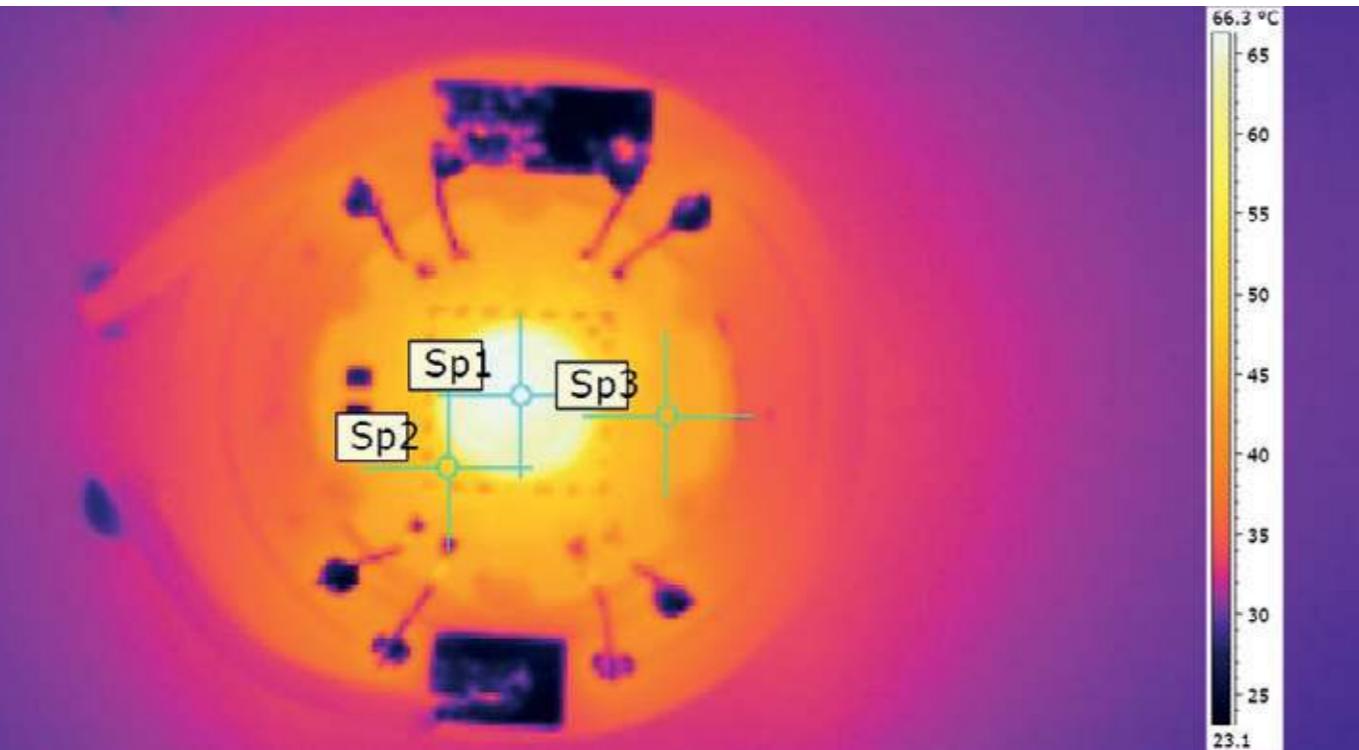


Thermisch leitfähige Klebstoffe

für kraft- und wärmeschlüssige Verbindungen in der
Mikroelektronik, Energie- und Elektrotechnik

Produktbroschüre

Thermisch leitend Kleben als Alternative zum Schweißen, Löten und Schrauben



Wärmeleitklebstoffe werden in der Verbindungs-technik eingesetzt, um Komponenten so miteinander zu fügen, dass eine dauerhafte mechanische Verbindung entsteht und gleichzeitig ein Wärmetransport vom wärmeren zum kälteren Bauteil ermöglicht wird. Thermisch leitendes Kleben ist damit in vielen Fällen eine Alternative zu den herkömmlichen Verbindungsverfahren wie Löten, Schweißen oder Schrauben.

Was ist Wärmeleitfähigkeit?

Die thermische Leitfähigkeit eines Werkstoffs ist eine materialspezifische Eigenschaft, die den Wärmefluss durch ein Probenvolumen beschreibt und in W/mK gemessen wird.

Typische Werte:

Wärmeleitklebstoffe: ca. 0,5 bis 5 W/mK
 Kunststoffe ohne Zusätze: ca. 0,2 bis 0,3 W/mK
 Glas, Keramik: ca. 1 bis 30 W/mK
 Metalle, Legierungen: ca. 10 bis 400 W/mK

Anwendungen für Wärmeleitklebstoffe

Egal ob in der Mikroelektronik, Fahrzeug- oder Energietechnik, ein gutes Wärmemanagement hilft dabei, die Lebensdauer des Endprodukts zu verbessern und damit seine Energieeffizienz und Umweltbilanz positiv zu beeinflussen.

Thermisch leitfähige Klebstoffe kommen in folgenden Bereichen zum Einsatz:

- Mikroelektronik:
Chipmontage, Verkapselung, Entwärmung
- Sensortechnik:
Verguss thermischer Sensoren
- Leistungselektronik:
Montage von Power-Modulen
- Energietechnik:
Verbinden von Rohren und Flächen in Wärmetauschern
- Automotive:
Verklebung bzw. Verguss von Batteriezellen, u.a. Elektromotoren

Vorteile des Klebens

Wärmeleitendes Kleben als Alternative zum Schweißen oder Löten ermöglicht das Verbinden beliebiger, auch schwieriger Materialkombinationen wie Kupfer und Aluminium. Die Klebung ist spaltfüllend, großflächig wärmeleitend und beständig gegenüber den meisten Prozessmedien wie Wasser, Öl oder Gasen. Da die Klebstoffe bei Raumtemperatur oder moderaten Temperaturen gehärtet werden, entstehen weder mechanische Spannungen in der Verbindung, noch unerwünschte Verformungen oder Verfärbungen.

Wärmeleitklebstoffe der nächsten Generation

Neue Anwendungen in der Energie- und Elektrotechnik erfordern höhere Wärmeleitfähigkeiten als bisher. Dies war der Anlass zur Entwicklung einer neuen Generation wärmeleitender Klebstoffe mit Wärmeleitfähigkeiten zwischen 1 und 4 W/mK und darüber. Die folgende Übersicht umfasst bewährte und neue Produkte und ermöglicht eine Klebstoffauswahl in Abhängigkeit von den gewünschten Verarbeitungs- und Endeigenschaften.



Verarbeitung	heiß härtend				
	kalt härtend		heiß härtend		
Komponenten	2K	1K		2K	
elektrisch isolierend	ja	ja	nein	ja	nein
<1 W/mK	TC 451 TC 417 TC 437	TC 351	–	TC 430	–
1-2 W/mK	TC 418 TC 432	–	TC 304 TC 301	TC 420 TC 418	–
2-4 W/mK	TC 423	–	–	TC 433 TC 423	–
>4 W/mK	–	–	EC 242 frozen	–	VP 2026

Wärmeleitende Pasten für wieder lösbare Verbindungen

Für den Fall, dass Fügeteile thermisch leitend verbunden, aber später ohne Beschädigung getrennt oder getauscht werden müssen, bieten wir dosierbare Pasten mit Wärmeleitfähigkeiten von 1 bis 3 W/mK und anwendungsgerechten Verarbeitungseigenschaften.

Varianten und kundenspezifische Entwicklungen

Sie vermissen ein Produkt mit bestimmten Eigenschaften? Viele dieser Klebstoffe sind auch als dünnflüssigere, thixotropierte, gefärbte oder fertig vorgemischte und tiefgefrorene Variante verfügbar. Wir entwickeln für Sie außerdem kundenspezifische Produkte nach Ihren Vorgaben. Bitte sprechen Sie uns an.

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Thermisch leitende Klebstoffe

Bezeichnung		Verarbeitungseigenschaften				Thermische Eigenschaften			Mechanische Eigenschaften				
Parameter	MV	Dichte	Viskosität ca.	Topfzeit bei 23 °C	Härtung	Wärmeleitfähigkeit	Max. Dauer-temperatur	Glas-temperatur	Shore-Härte	Zugscherfestigkeit	Zugfestigkeit	E-Modul	Bruchdehnung
Methoden	–	PT TM 201	PT TM 202*	PT TM 702	–	PT TM 502***	PT TM 302	PT TM 501	PT TM 601	PT TM 604	PT TM 605	PT TM 605	PT TM 605
Einheit	nach Gewicht	g/cm³	Pa s	–	Beispiele	W/mK	°C	°C	–	MPa (Al/Al)	MPa	GPa	%
TC 437	100:10	1,4	6	2 h	23 °C, 16 h	0,6 ±0,1	180	85	D80	16	42	5,8	0,9
TC 430	100:4	1,4	13	2 Tage	150 °C, 15 min	0,7 ±0,1	250	110	D85	11	44	5,6	0,9
TC 351	–	1,9	60	1 mon	120 °C, 45 min	0,8 ±0,1	200	110	D80	20	56	11	0,7
TC 417	100:13	1,8	3	6 h	23 °C, 24 h	0,8 ±0,1	180	80	D85	18	71	7,4	1,1
TC 451	100:6	2,0	9	30 min	23 °C, 16 h	0,8 ±0,1	180	110	D90	14	71	10	0,9
TC 420	100:11	2,1	22	24 h	120 °C, 15 min	1,1 ±0,2	200	90	D85	15	62	15	0,5
TC 304	–	1,8	35	1 mon	150 °C, 10 min	1,4 ±0,2	180	80	D85	17	65	7,4	1,6
TC 418	100:65	2,5	40-60**	4 h	23 °C, 48 h 120 °C, 30 min	1,6 ±0,2	160	<25	D36/A94	3	2	0,04	3,0
TC 432	100:7	1,5	60-70**	15 min	23 °C, 24 h	1,8 ±0,2	190	75-80	D65	9	36	10	0,4
TC 301	–	2,0	43	1 mon	120 °C, 45 min	1,9 ±0,2	180	80	D85	23	59	12	0,8
TC 433	100:5	1,5	90-100**	6 h	150 °C, 15 min	2,0 ±0,2	220	110	D83	9	24	6,0	0,4
TC 423	100:1,7	3,0	50-80**	30 min	23 °C, 24 h 120 °C, 30 min	3,0 ±0,5	160	60 - 65	D92	10	29	23	0,1
EC 242 frozen	–	5,3	20	24 h	150 °C, 30 min	4,2 ±0,5	230	110	D85	7	34	9,0	0,4
VP 2026	100:2	4,9	n.b.	6 h	150 °C, 15 min	6,5 ±1,0	165	85 - 90	D83	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

* dynamische Viskosität bei 23 °C, Platte-Platte, Spalt 0,5 mm, Schergeschwindigkeit bis 84 s⁻¹

** dynamische Viskosität bei 23 °C, Platte-Platte, Spalt 0,25 mm, Schergeschwindigkeit konstant 10 s⁻¹

*** THB (Thermal Hot Bridge)-Methode und/oder Laser Flash-Messungen in Anlehnung an ASTM E1461

Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um circa-Werte, diese sind nicht Teil der Produktspezifikation.